

シリコランダム

最高使用温度 °C	SiC %	気孔率 %	かさ比重	圧縮強度 Mpa	熱間膨張率 % (1000°C)	熱伝導率 W/m・°C (350°C)	荷重軟化温度 0.2MPa T ₂ , °C	耐酸化性	スポーリング抵抗
1500	>90	8~16	2.6	>98	0.4~0.5	18.4	>1600	良好	良好

シリコライト

最高使用温度	SiC %	気孔率 %	かさ比重	圧縮強度 Mpa	熱間膨張率 % (1000°C)	熱伝導率 W/m・°C (350°C)	荷重軟化	電気抵抗 Ω-cm	耐酸化性	スポーリング抵抗
酸化雰囲気中 1700°C COによる還元雰囲気中 2000°C	>98	25	2.4	78	0.47	17.4~23.3	1800°Cでも認められない	常温において100~200他の比非常に低いのが特徴	良好	良好